

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2021 年 03 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<u>03 月 05 日 10:30-11:30</u> 浙商证券 博时基金 <u>03 月 12 日 13:30-15:30</u> 国金证券 海通证券 东海证券 中银资管 东吴电子 聚鸣资本 红山资本 寻常投资 景林资本 天弘基金 Capital International
时间	03 月 05 日 10:30-11:30 03 月 12 日 13:30-15:30
地点	华润微电子总部会议室
上市公司接待人员姓名	彭 庆 华润微电子董事、助理总经理兼财务总监 吴国屹 华润微董事会秘书兼战略总监

投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司目前对 2021 年全年行情的看法？ 现阶段市场延续了去年下半年的景气行情，公司目前在手订单饱满，对 2021 年全年行业景气度维持乐观的态度。 问题二：春节假期对公司的生产经营有无影响？ 今年政府倡导“就地过年”，公司春节期间整体产线维持正常运行。公司在春节期间对六吋晶圆产线安排了动力检修，对六吋产能会略有影响。 问题三：公司什么时候实施定向增发？ 公司已于 2021 年 2 月 4 日收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于华润微电子有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司正在积极推进定增项目，预计在四月内完成定增。 问题四：公司有无考虑采取进一步涨价的措施？ 公司会针对客户结构、不同产品线及其终端应用等因素考虑相应的价格策略来改善供给紧张的情况，同时公司内部产能会做一些结构性的调整，优先用于供需紧张的产品。 问题五：公司的上游硅片、材料等有无明显的涨价趋势？ 受疫情影响，有一些化学药品和六吋硅片的价格略有上涨，但是调整的幅度不大，且占公司整体成本的比重不高。目前国内八吋硅片价格保持稳定，现阶段公司尚没有看到明显的涨价趋势。 受近期铜价上涨的影响，封装需要的引线框架成本有所上涨，但是该部分占封装整体成本比重不大，封装整体成本保持平稳。 问题六：公司的自有产品在整个营收的占比？ 目前公司自有产品的营收占公司整体营收的
----------------------	--

	比例约为 45%，公司的长期目标是将自有产品的营收占比提升到 60%及以上。 问题七：公司在晶圆制造方面，今年有无新增产能？ 公司无锡八吋线的募投项目已经开始建设，预计会在今年下半年释放一部分产能，主要和 BCD、MEMS 产品有关；重庆八吋线升级改造项目也将会为今年新增一部分产能。 问题八：公司 12 吋产线何时可以贡献产能？目前规划的产能是多少？ 公司 12 吋产线预计在 2022 年可以实现产能贡献。目前该产线规划月产能为 3 万片，未来将全部用于生产自有功率器件产品。 问题九：公司 MOSFET 产品下游客户的突破情况？ 中低压 MOSFET：公司的 SGT MOS 在高端电源、通信设备等热门领域已经有所突破，预计销售额会在 2021 年、2022 年实现增长。 高压 MOSFET：公司与逆变器、基站电源等知名客户达成合作，公司的第五代超结产品已经稳定出货。 问题十：公司在第三代化合物半导体领域的有哪些进展？ SiC 方面，公司在去年 7 月份召开了 SiC 二极管产品发布会，经过半年的市场推广和验证，已经实现小批量供货。我们预计今年将进一步推出 SiC MOSFET 产品。此外，公司积极布局 SiC 上下游产业链，参股了一些 SiC 材料端的公司，更好地保障 SiC 产品供应链。 GaN 方面，6 吋和 8 吋产品同步研发，利用现
--	--

	有的全产业链优势，从衬底材料，器件设计、制造工艺，封装工艺全方位开展硅基氮化镓的研发工作，预计今年有新产品推出。 问题十一：公司如何看待未来几年，功率板块中各类自有产品的成长空间？ 一、MOSFET 方面：目前国内约 90% 的高端产品市场份额仍被国外厂商占据，公司正在积极布局中高端领域，未来国产替代空间大。 二、IGBT 方面：在该领域公司未来主要的增量来自于产品应用领域的突破以及 IGBT 模块产品的上量，公司模块产品已在工业电源方面与客户完成了初步测试，预计今年会实现销售收入的突破。 三、IPM 模块：目前公司自有 IPM 模块产品已稳定出货。 问题十二：公司在汽车电子上的进展和规划？ 汽车电子是公司未来重点发力的方向，公司目前在汽车电子方面的主要应用是车载逆变器、车灯照明与驱动、车载充电、车载音响等。此外，公司也有产品已经切入了电动汽车控制器领域。 公司从外延和内部研发两个方面努力切入汽车电子：公司已通过收购杰群电子 70% 的股权切入汽车级电子封装，其他与汽车电子相关的公司也是我们重点关注的目标；同时公司内部也会做相关产品的研发工作，积极与整车厂商开展合作，现阶段已经拥有一定的技术积累，并将积极引进相关领域的专业人才。 问题十三：公司内部对人才有哪些激励机制？ 公司对于研发人员采取了多种激励措施：实施市场化的薪酬体系；建立项目跟投、研发项目激励等制度；同时积极推动员工股权激励方案。
--	--

日期	2021 年 03 月